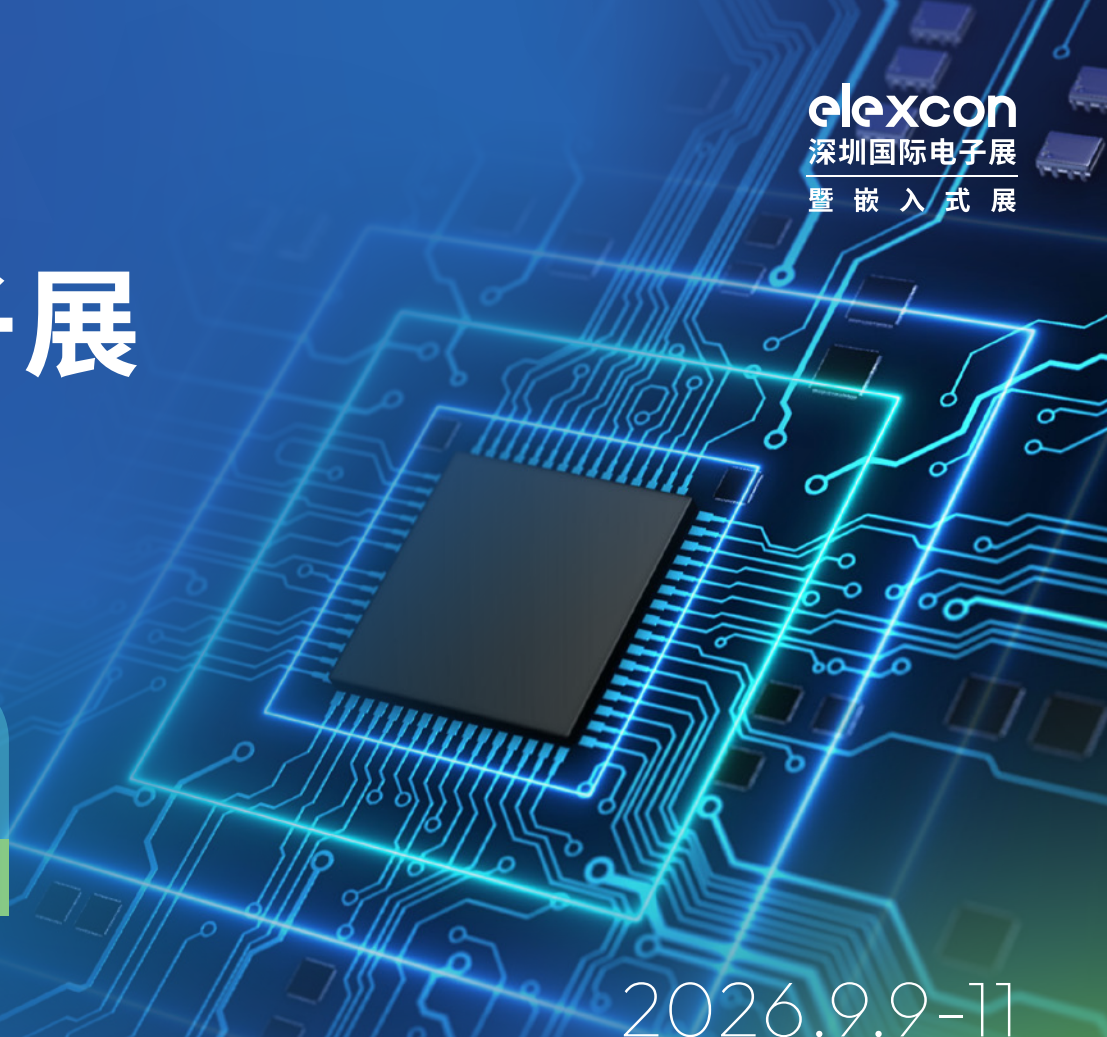
elexcon
深圳国际电子展
暨嵌入式展

深圳国际电子展
暨嵌入式展

elexcon 2026

展后报告

POST SHOW REPORT



All for AI, All for GREEN

为AI和双碳提供全栈技术与供应链支持

2026.9.9-11

深圳国际会展中心(宝安)

SHENZHEN WORLD EXHIBITION AND CONVENTION CENTER

目录 CATALOGUE

↘ 展后回顾 1

↘ 展商概览 2

↘ 部分参展企业代表 3

↘ 观众概览 5

↘ 参观代表企业 7

↘ 同期会议 8

↘ 同期会议嘉宾 10

↘ 同期活动 11

↘ 颁奖活动 12

↘ 三展联动——赋能AI算力基础设施 13

↘ 三展联动——聚力消费电子与AR/VR创新，打通端侧交互全产业链 14

↘ 三展联动——赋能智能汽车及具身机器人 15

↘ 线上线下联动，放大展期品牌声量 16

↘ elexcon2027深圳国际电子展暨嵌入式展 17



展后回顾
POST-SHOW REVIEW

20,000M² 展示面积

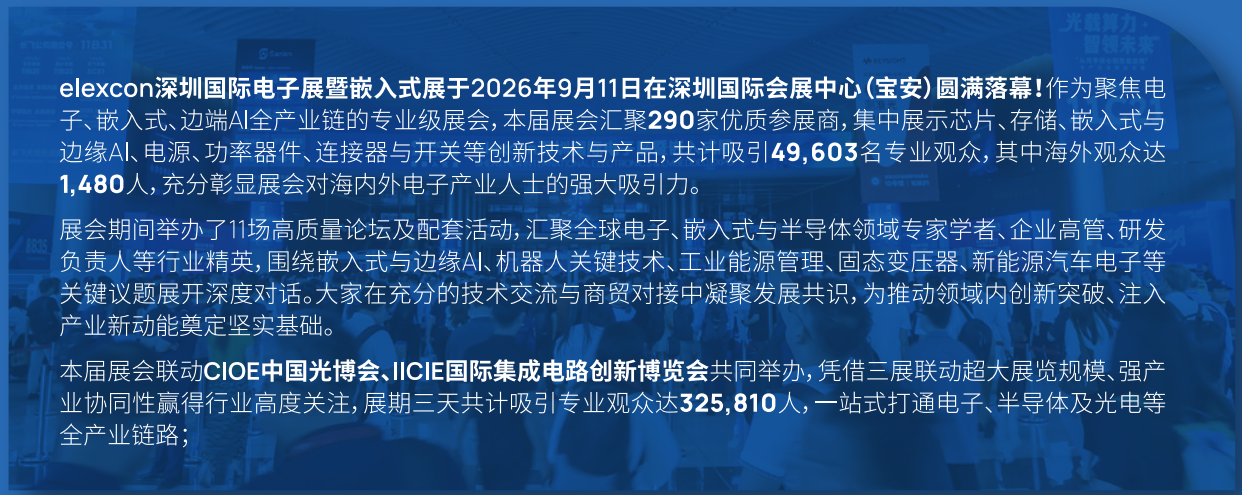
49,603 专业观众

1,480 海外观众

290 参展企业

60+ 参观团

11 论坛活动



elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展于2026年9月11日在深圳国际会展中心（宝安）圆满落幕！作为聚焦电子、嵌入式、边端AI全产业链的专业级展会，本届展会汇聚**290**家优质参展商，集中展示芯片、存储、嵌入式与边缘AI、电源、功率器件、连接器与开关等创新技术与产品，共计吸引**49,603**名专业观众，其中海外观众达**1,480**人，充分彰显展会对海内外电子产业人士的强大吸引力。

展会期间举办了11场高质量论坛及配套活动，汇聚全球电子、嵌入式与半导体领域专家学者、企业高管、研发负责人等行业精英，围绕嵌入式与边缘AI、机器人关键技术、工业能源管理、固态变压器、新能源汽车电子等关键议题展开深度对话。大家在充分的技术交流与商贸对接中凝聚发展共识，为推动领域内创新突破、注入产业新动能奠定坚实基础。

本届展会联动**CIOE中国光博会、IICIE国际集成电路创新博览会**共同举办，凭借三展联动超大展览规模、强产业协同性赢得行业高度关注，展期三天共计吸引专业观众达**325,810**人，一站式打通电子、半导体及光电等全产业链路；

展商概览

81.7%

展商愿意向同行及
行业伙伴推荐

86.7%

对2026年展会总体参展效果
表示满意或非常满意

94.4%

表示会继续参展

290

参展企业



部分参展企业代表

芯片及模组

存储

电子元器件

*以上仅部分企业，排名不分先后

部分参展企业代表

嵌入式





























电源





















连接器


















其他











*以上仅部分企业，排名不分先后

观众概览

观众所属行业

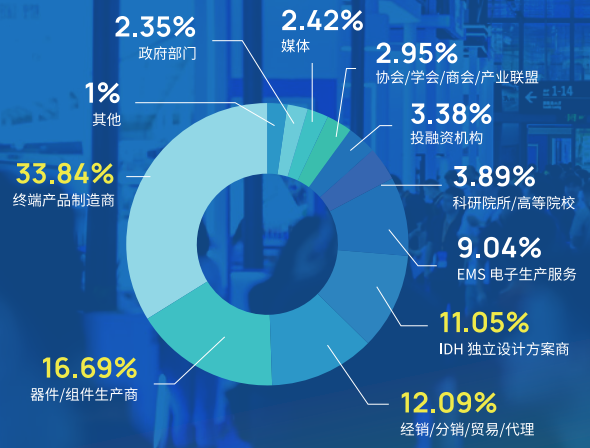
- 21.11% 消费电子及智能终端
- 15.89% 通信网络设备及系统
- 15.50% 工业/机器人
- 13.20% 芯片与元器件
- 9.39% 计算与通信
- 7.53% 电力与电源
- 6.58% 汽车电子/新能源汽车
- 4.66% 嵌入式系统
- 3.81% 医疗
- 1.35% 安防
- 0.98% 其他

观众所关注的产品

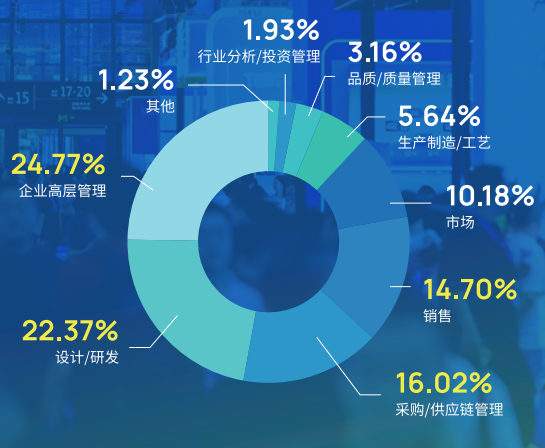


观众概览

观众所属公司类型



职位分析



观众在采购中的作用



采购推荐/建议权

47.79%



最终决策权

31.50%



不参与采购

20.71%

海外观众部分来源国家


韩国


日本


新加坡


美国


马来西亚


印度


泰国


德国


孟加拉国


巴西

参观代表企业

消费电子及智能终端

美的、TCL、华为、小米、极米科技、欧菲光、安克创新、创维、海尔、vivo、石头科技、OPPO、中兴、步步高、传音、蓝思科技、大疆、Sony、小天才、联想、CASIO、志高；

汽车电子/新能源汽车

小米汽车、比亚迪汽车、北汽研究院、理想汽车、德赛西威、航盛电子、中集车辆、广汽研究院、四维图新、吉利汽车、小鹏汽车、拓邦、绿传、马瑞利；

通信网络设备及系统

华为、中兴通讯、上海诺基亚、新华三、锐捷网络、信科移动、东方通信、移远通信、广和通、富士通、海能达、研华科技、纵横通信、工业富联；

计算与通信

中国移动、中国电信、中国联通、字节跳动、金山云、腾讯、中科曙光、京东、百度、小红书、浪潮信息；

工业

汇顶科技、长盈精密、汇川技术、华工自动化、灿弘自动化、大族激光、欧姆龙、工数创新、雷赛智能、普莱信、禾川科技、研祥、亿达电子、台达、固高科技；

机器人

优必选、埃斯顿机器人、安诺机器人、思灵机器人、江特电机、兆威机电、宇树机器人，智元机器人、雷赛智能、节卡机器人、逐际动力、众擎、星海图；

医疗

圣安医疗、鱼跃医疗、瑞派医疗、迈瑞医疗、开立医疗、东升医疗、乐普医疗、麦科田医疗、华测检测、绿茵医疗、精锋医疗、西门子医疗；

安防

商汤科技、同为数码、旷视科技、熵基科技、海康威视、英飞拓、高新兴、捷顺科技、安居宝、浩云科技、佳都科技、力维、天视通、万佳安等；

电力与电源

西门子、英威腾、台达、欣旺达、绿联、麦格米特、维谛、施耐德、伊顿、华为数能、阳光电源、航嘉、世达能源、长城电源、村田、金升阳、科士达、科华数据、盛弘股份、中恒电气、易事特、锦浪、固德威、上能电气；

芯片与元器件

英伟达、高通、英飞凌、ADI、意法半导体、NXP、海思、豪威集团、紫光展锐、MPS、闻泰科技、澜起、时代电气、士兰微、斯达半导、比亚迪半导体、平头哥、北京君正、昆仑芯、南芯、扬杰科技、华大电子、芯旺微、富满微、瑞能半导体、晶华微；

同期会议

第八届中国嵌入式技术大会

作为国内最活跃的嵌入式生态大会，自2019年创办以来已累计吸引全球30多个国家、10000余名开发者及500余家产业链企业参与。本届会议围绕端侧大模型落地、边缘智能架构、RISC-V 与 NPU、具身智能机器人、国产MCU与工业操作系统等产业方向展开分享与探讨，打破了芯片原厂、系统厂商与终端用户之间的沟通壁垒，为端侧AI从原型走向量产、国产软硬件协同落地搭建了高质量对接平台。

部分演讲嘉宾

- **何小庆** 嵌入式系统联谊会秘书长
- **毕盛** 华南理工大学副教授
- **林金龙** 北京大学教授
- **陈刚** 中山大学教授
- **谢国琪** 长沙理工大学教授、院长
- **陈昌川** 重庆邮电大学副教授
- **杨瑞** Arm高级嵌入式市场经理
- **申靓** NXP Seminconductors 恩智浦大中华区高级市场经理
- **林思源** 研华科技资深产品经理
- **申壮** 达摩院-玄铁RISC-V解决方案部门高级AI工程师
- **Stefan Schmidt** Linaro技术负责人、首席专家
- **谢先国** 益登科技高级现场应用工程师
- **凌滔** 瑞萨电子高级应用工程专家
- **沈奕鹏** 中电港萤火工场副总经理
- **林德丰** 安勤科技总经理
- **张一峰** ADI中国区产品市场经理
- **田仁俊** 研华科技资深产品经理
- **吴伟** 上海芮芽科技（Kubuds）联合创始人
- **陈毅东** 兆威机电副总经理
- **王莎莎** 瑞萨电子高级现场应用工程专家
- **李涛** 睿赛德（RT-Thread）华南区商务总监
- **郭腾冉** 灵动微电子MCU市场经理
- **郑增忠** 航顺芯片产品总监

固态变压器（SST）技术创新与产业发展论坛

本次论坛围绕SST功率单元、SiC驱动、中频变压器（MFT）、高频双向DC/DC、测试验证与 AIDC 供电架构展开交流。部分参与企业如澳通韦尔研发总监许弟华，Murata 资深产品工程师肖坤，艾德克斯技术工程师宋辰辰，浙江大学副教授、博士生导师李楚杉，威派森研发总监郑庆杰等；



新能源汽车电子创新技术论坛

与OE汽车联合主办，本次论坛汇聚了整车厂、Tier1供应商、芯片原厂及行业权威专家，围绕AI赋能、电子电气架构演进、智能驾驶及舱驾融合等核心议题展开深度探讨，为新能源汽车电子产业的未来发展指明了方向。部分参与企业如**长安大学汽车学院、北汽研究院、德赛西威、岑科科技、上海贝岭、中科创达、康谋科技等；**

第十届中国系统级封装大会

围绕宏观趋势与生态共建、2.5D/3D Chiplet 异构集成、光电互连、工艺材料与设备四大方向，芯和半导体、天孚通信、阿里云担任主席单位，芯和半导体创始人兼董事长凌峰博士担任大会主席，阿里云智能集团首席云服务器架构师和资深研发总监陈健、苏州天孚光通信副总裁刘宏钧担任分论坛主席。



芯片及芯片应用主题会议

第三届AI赋能消费电子创新论坛

与华强电子网联合主办，聚焦AI与消费电子融合的最新趋势，围绕AI算力、端侧部署、MLCC产业趋势、数字健康等核心议题，搭建了“技术-产业-供应链”高效对接平台。参与的企业有ams OSRAM、**尚锐兴科技、好上好信息、微容电子、华强电子产业研究所等；**

- **部分分享的话题：**
- AI重构消费电子新生态：2026产业周期与新增长极
- 从算力跃迁到器件革新——AI服务器MLCC应用趋势与解决方案
- 构建开放端侧AI生态，加速产业智能化落地
- 从千亿到万亿参数：自研并行架构驱动AI推理规模化落地



端侧AI芯势力：2026智能终端芯片生态峰会



智算之源：2026芯算力创新峰会

汽车芯片产业创新论坛

与芯师爷共同合作举办《端侧AI芯势力·2026智能终端芯片生态峰会》、《汽车芯片产业创新论坛》、《智算之源·2026芯算力创新峰会暨第八届硬核芯颁奖盛典》，全景解码万亿芯时代的AI落地路径。部分参与企业如**复旦微电子、星凡智能、苏州国芯、深境智能、京微齐力、群智咨询、北汽研究院、紫光同芯、武汉二进制、航盛电子、杰发科技、芯桥半导体、灿芯半导体、灵睿智芯、SiPhiinc、六岳微、微容科技等；**

- **部分分享的话题：**
- 存储芯速度，存算一体突破AI带宽墙
- 物理AI时代的端侧芯片机遇
- 基于RISC-V与NPU融合的智能传感器创新
- 用芯铸就智能网联汽车安全底座
- 舱驾融合的趋势与实践
- 智能驾驶技术融合创新与落地
- 智算新纪元：从底层架构创新到全场景算力生态
- CPO 只是开始：AI算力真正需要怎样的光互连？
- 从400G到1.6T：AI算力浪潮下高速光模块演进与MLCC应用机遇

第二届边缘AI与智能控制技术行业论坛

本届论坛以"自主芯链，智能边缘为主题，聚焦国产芯片工业应用、AI存储生产力、ARM 智能终端vPLCnext虚拟控制技术、具身智能柔性产线等议题，共筑自主敏捷的制造未来。部分参与企业如**国民技术、特控电子、节卡机器人、菲尼克斯、协创数据等；**

更多同期主题会议如

- RISC-V产业生态创新大会
- 《Chip》芯片设计创新发展论坛
- EDA与IP电子设计论坛
- 具身智能产业大会——从算力到执行，构建具身智能系统

同期会议嘉宾



凌峰
芯和半导体科技（上海）股份
有限公司
创始人&董事长



陈健
阿里云智能集团
首席云服务器架构师
和资深研发总监
/CXL和UCIe董事会成员



何小庆
大会主席
&嵌入式系统联谊会秘书长



郝沁汾
中国科学院
计算技术研究所



毕盛
华南理工大学
副教授



林金龙
大会专家委员会
&北京大学
软件与微电子学院教授



张哲
河北工业大学
教授



刘宏钧
苏州天孚光通信股份
有限公司
副总裁



杨瑞
Arm
高级嵌入式市场经理



申靓
NXP Seminconductors
恩智浦大中华区
高级市场经理



申壮
达摩院-玄铁
RISC-V 解决方案部门
高级AI工程师



张一峰
Analog Devices, Inc.
ADI 中国区产品市场经理



林德丰
安勤计算机应用科技
(上海)有限公司
总经理



杜军
岑科科技(深圳)集团
有限公司
新能源总经理



Bert van Weelde
德国库尔特埃莎半导体
业务拓展总监



Stefan Schmidt
Linaro Ltd
Linaro expert



韩天
阿里
系统架构师



林大洋
北汽研究总院
智能网联中心
专业总师



谢光元
京泉华
研发总工



陈毅东
深圳市兆威机电股份
有限公司
副总经理

*以上仅为部分演讲嘉宾，排名不分先后

三展联动欢迎晚宴

作为elexcon、CIOE、IICIE三展联动的高端活动，欢迎晚宴集结电子、光电、半导体领域超800位国内外企业决策者、技术领军人才及行业专家。现场营造开放融洽的交流氛围，为参会嘉宾搭建高效对接渠道，围绕产业协同发展、技术创新突破开展互动研讨，赋能产业链上下游合作共赢。





Kaifa Gala大湾区开发者/工程师大会

以开发者真实研发需求为核心，搭建真机实操工坊，集中陈列多款搭载国产芯片的端侧AI开发板。到场研发工程师无需预约即可上手实操，现场完成模型烧录、算子调试、外设对接等操作，直观实测国产芯片算力水平、模型部署速度及硬件外设兼容性，切身感受国产嵌入式平台的开发体验。

专区内常驻国内芯片原厂技术专家，针对工程师现场提出的底层驱动移植、AI模型轻量化部署、硬件EMC兼容性调试、功耗优化等工程难题提供一对一答疑。不少工程师带着项目选型需求来到专区，现场对比多款国产开发板的性能差异，评估方案适配性。

汽车电子专场采供对接会

专为拥有采购决策权或建议权的整车、Tier1汽车电子企业高层与专业采购人士，精心打造专业高效的汽车电子采供对接平台。展前定向邀约主机厂、Tier1采购团队，深度挖掘车规芯片元器件、硬件方案等真实采购需求，为其精准筛选匹配符合车规标准的elexcon参展商及产品方案。现场供需双方就前沿技术产品与采购需求进行了深入的沟通与洽谈，不仅促成了多项潜在合作，更有效打通了汽车电子产业链的供需内循环，加速了创新技术从实验室走向量产车的商业化进程。

部分参与的买家名单：

四维图新、吉利汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、拓邦、绿传、马瑞利、茂翔、索斯科、亚马逊、Qontrol VisuAI等；



颁奖活动

elexcon2026嵌入式与边缘AI创新奖

随着人工智能从云端加速向终端下沉，边缘AI已成为嵌入式系统与元器件技术创新发展的核心驱动力。

为表彰边缘AI领域的技术创新突破、产品迭代升级与市场规模化落地成果，

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展携手各行业专家及权威行业媒体，重磅打造了“elexcon2026嵌入式与边缘AI创新奖”；



嵌入式技术大会
杰出贡献奖



边缘AI芯片领军
企业奖



边缘AI核心器件
突破奖



边缘AI解决方案
创新奖



最具潜力
边缘AI新创新奖



国产AI
优质无源器件奖

端侧 AI 开发板特别奖项

最受工程师喜爱的AI开发板TOP 10

获奖企业：意法半导体、飞凌嵌入式、TI、瑞萨电子、英飞凌科技、NXP、Nordic Semiconductor、灵眸科技、飞凌微、玄铁







三展联动——赋能AI算力基础设施

链通算力-存储-互联-应用，构筑AI算力全栈硬件底座

今年elexcon联动CIOE、IICIE共同举办，这并非三场展会的简单相加，而是对产业边界的突破与重构，三展联动贯通 AI 算力芯片→硅光/CPO高速光互联→存储与配套硬件→终端行业应用完整创新链条，依托芯片算力、高速互联、大容量存储协同，破解计算、传输、存储三大瓶颈，夯实国产 AI 算力系统底层支撑能力。

【芯片企业】：深耕芯片底层布局，健全国产 AI 算力全链条生态；

代表企业：兆易创新、国民技术、灵动微电子、中兴微、北京君正、华强半导体、国芯科技、算能科技、珠海芯动力、达摩院玄铁、思凯迈、象帝先、澜昆微、云联半导体、安信达等；

【存储器件｜电源与供配电｜嵌入式硬件】：
搭建分层高速存储架构，破解存储墙瓶颈，配套供配电、嵌入式硬件，夯实算力硬件支撑底座；

代表企业：长江存储、华大电子，长江万润、朗科、东芯半导体、宇瞻、科摩思、德明利、澜起科技、研华科技、SEGGER中国（哲戈微）、安勤科技、上海贝岭、爱浦、信安半导体、芯控源、荣和美、京泉华、科达嘉、华晟电通、德鸿感应、西普尔、步步精、硕凌、宇熙、信维电子、微容、厚声、宇阳、芯声微、富捷电阻、中电港、立功科技、创意电子、深圳华强等；

【硅光｜CPO｜高速光互联】：
搭建算力高速光互联网络，解决跨节点海量数据传输带宽、功耗难题；

代表企业：COHERENT高意、海思、光迅、华工正源、新易盛、纳真科技、剑桥、立讯技术、联特、智禾光通、CORNING、长飞、亨通、华三、锐捷网络、烽火、光库等；

*以上仅部分企业，排名不分先后



三展联动——
聚力消费电子与AR/VR创新，
打通端侧交互全产业链

消费电子与AR/VR技术融合加速，光学感知、新型显示、端侧算力等多技术板块高度交叉，单一展会难以汇聚完整生态。elexcon、IICIE、CIOE三展联动，整合消费电子、AR&VR全产业链资源，一站式呈现AI　嵌入式、芯片存储、光学成像与感知、新型显示、AR/VR核心器件及测试测量技术，助力企业对接上下游伙伴，也能更高效的吸引终端等核心观众；

部分展示产品及代表企业：

嵌入式：研华科技、安勤科技、SEGGER中国（哲戈微）、璞致电子、芯驿电子、正点原子、韬睿、晟天维、Linaro等；

存储：长江存储、长江万润、朗科、北京君正、东芯半导体、宇瞻、科摩思、德明利、喻芯半导体、迈德迩、金胜、舜铭、华芯星、威刚、豪杰创新、妙存科技、博雅、华讯、澜起科技、成都华微等；

芯片：中兴微电子、灿芯半导体、国芯科技、京微齐力、泰芯半导体、一微科技、智现未来、九芯电子、凌烟阁、唯创知音、华大电子、芯龙半导体、速显微、灵动微电子、北京君正；

光学镜头及模组：舜宇光学、凤凰光学、宇瞳光学、AAC Optics、联合光电、特莱斯光电、弘景光电、福光股份、永新光学、中光学集团、成都光明、光电集团、蓝特光学、联合光科、立讯精密；

3D视觉：艾迈斯欧司朗、芯视界、睿熙科技、瑞识科技、志强视觉、见行科技、美芯晟科技；

光波导及AR&VR：中科融合、立讯精密、歌尔光学、首镜科技、理湃光晶、AAC Optics、谷东科技、小象光显、鲲游光电、诠视科技、InsEye、Raontech、鸿石、MyRias、Illusion、万有引力、康耐特、海联晶盛、微宇视界、Brilliance、泰美克，慕德微纳、拓比Tobii；

*以上仅部分企业，排名不分先后





三展联动——
赋能智能汽车及具身机器人

三展联动整合智能汽车全产业链资源，一站式集中展示车载光通信、多传感器融合解决方案、车载显示、汽车三电系统、整车连接线束等，五大技术板块完整覆盖智能汽车感知、高速传输、动力供给、整车布线、座舱交互全技术链路；

部分展示产品及代表企业：

存储：长江存储、长江万润、东芯半导体、德明利、科摩思、威刚、宇瞻、华芯星、朗科、喻芯半导体、迈德迩、豪杰创新，金胜、澜起科技、成都华微等；

芯片：比亚迪半导体、华润微电子、二进制半导体、北京君正、爱特微、紫光国微、复旦微电子、极海半导体、成都华微电子、谱瑞集成、智芯科、中科本原、码灵半导体、芯龙半导体、Advinno；

嵌入式：研华科技、SEGGER中国（哲戈微）、安勤科技、璞致电子、芯驿电子、正点原子、韬睿、晟天维、Linaro等；

车载显示：水晶光电、赛富乐斯、芯视元、思坦科技、立琻半导体、镭昱光电、视涯、昀光科技、西湖烟山科技、芯视佳、宏禧科技、诺视科技；

车载网络：长飞、烽火、科谱、华工正源、CORNING、欧亿光电、乐庭智联、永鼎、华晟福涛；

3D视觉：艾迈斯欧司朗、芯视界、睿熙科技、瑞识科技、志强视觉、美芯晟科技、芯探科技、力策科技、国微感知、蓝海光电；

*以上仅部分企业，排名不分先后

线上线下联动，放大展期品牌声量

全方位线上营销

展会整合官方网站、小程序、社交平台、电子快讯等多元线上渠道，精准定向营销，高效触达行业目标受众，为参展企业持续引流曝光。

邮件发送量
9,004,961+

展会网站访问量
342,479+

小程序累计用户
150,000+











与**响指、芯查查、半导体行业观察、中华工控网**等行业媒体合作展会期间对企业进行现场采访，打造多维度营销矩阵；同时与全球电子及应用行业媒体、协会强强联手加大对展会的曝光；

新闻报道
350+

现场直播访客量
82,000+

elexcon2027深圳国际电子展暨嵌入式展

展示范围

- 芯片与存储
- 嵌入式
- 电子元器件
- PCB&PCBA
- 电源及功率半导体
- 检测与测试测量
- 线束/连接器/开关
- MEMS与传感器
- EDA 软件和工具
- 应用及解决方案
- 操作系统及软件

六大前沿技术专区



01
AI 智能
终端技术



02
AI 算力技术



03
嵌入式与
边缘计算



04
下一代
电源技术



05
具身智能
机器人技术



06
无线
连接技术

展馆分布图

2027年9月8-10日 I 深圳国际会展中心（宝安）



HALL 15 elexcon 深圳国际电子展 暨嵌入式展

同期展会

HALL 14/16 IICIE 国际集成电路创新博览会

HALL 1-13 CIOE 中国光博会

www.elexcon.com

官方微信公众号

官方小程序